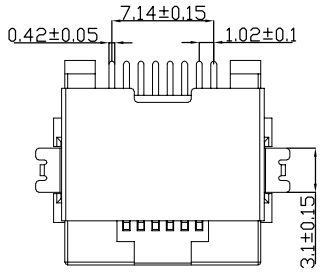
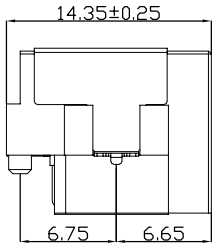
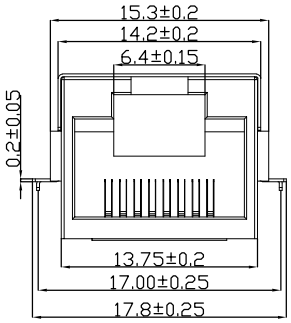
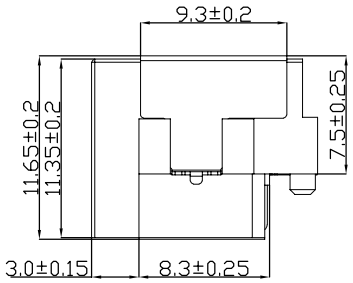








主要参数:

1.额度电压、电流:125V/1.5A max

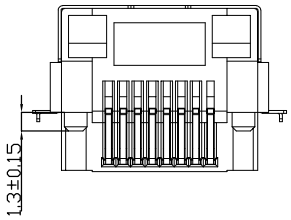
2.接触电阻:40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态

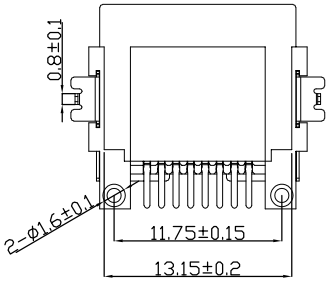
3.绝缘电阻:500MΩMin

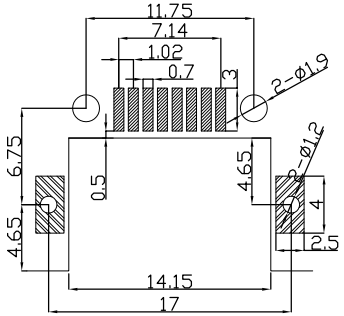
4.耐压测试:DC500V

5.盐雾测试:8±0.5H

6.焊接温度：260±5℃ 3±0.5s







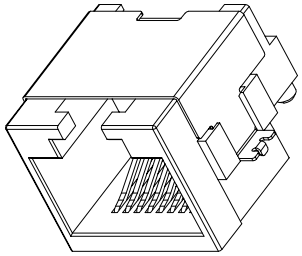
PCB参考图

其他要求

1.产品应无错装。漏装零件等现象;

2.零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观

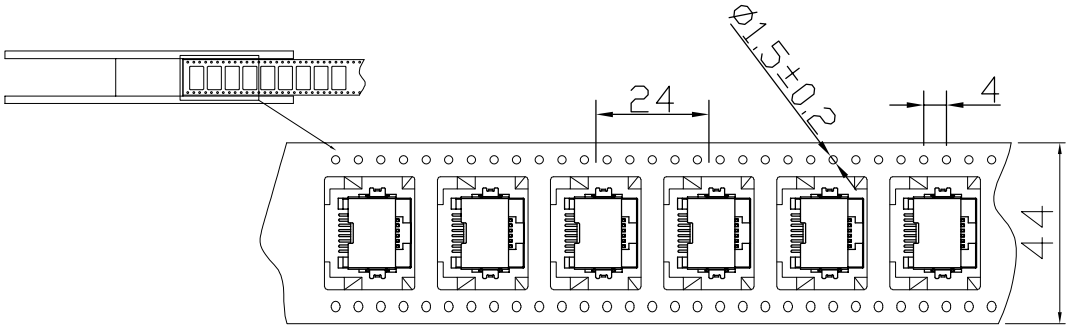
3.未注尺寸公差为±0.15mm



序号	名称	材料	电镀	备注
3	信号针	磷铜t=0.3	接触点镀金Fu″ 焊接脚镀锡≥80u″	
2	塑座	LCP	黑（环保）	
1	屏蔽	H62黄铜t=0.2	镀镍≥50u″	

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	
				X.X ±0.30	版本	A
				X.XX ±0.20	比例	1:1
				X.XXX ±0.10	投影	
				Angle ±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期	品名	RJ055F-1沉板贴无灯半包反向
编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-RJ45-SW055F-1
审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
批准	田泽民 21.09.25		



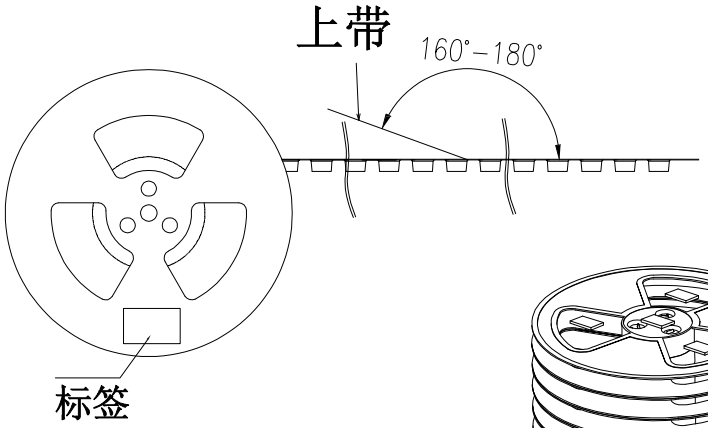
编带产品装箱示意图

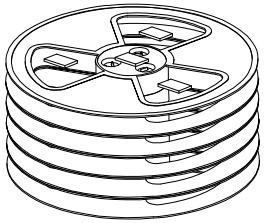
注:

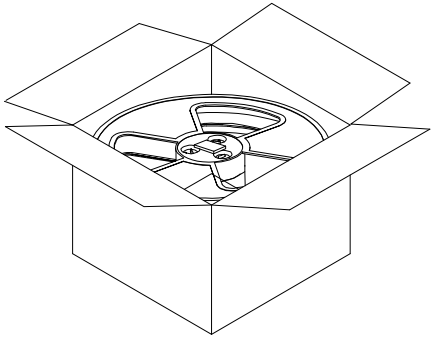
1. 纸箱为K=K材质
2. 外箱表面清洁.
3. 此箱需通过我司IQC相关测试标准。
4. 每盘装250PCS,
5. 每箱装10盘 ,250*10=2500PCS
6. 未注明公差±0.2mm

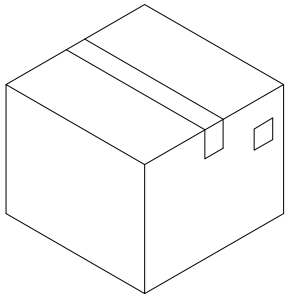
物料标签

供应商		客户订单	
规格型号			
物料编码			
装箱数量			
生产日期			









更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位		标准化	签名/日期	品名	RJ055F-1沉板贴无灯半包反向
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-RJ45-SW055F-1
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				

产品规范

MODULAR JACK CONNECTOR

目　录

1. 范围…… 2
2. 参考文件…… 2
3. 结构 & 组成…… 2
4. 额定值…… 2
5. 测试环境…… 2
6. 外观…… 2
7. 测试条件与要求摘要…… 2
8. 包装，运输，储存…… 4
9. 温度 …… 4

版本	ECN 编号	变更履历	日 期	签 名
A0	N/A	初版发行	2017.10.26	

产品规范

MODULAR JACK CONNECTOR

1. 范围

本规范适用于 **MODULAR JACK CONNECTOR RJ45/RJ11** 系列产品。

2. 参考文件

除非特别说明，当此产品规范的要求与产品图有异议时以产品图为准；当此产品规范的要求与参考文件有异议时以产品规范为准。

A. EIA-364：电子连接器和插座类产品测试方法。

B. FCC 标准。

3. 结构&组成

产品的设计，结构和物理尺寸参照适用的产品图。

4. 额定值

项目	规格	
额定电压	**125V**	AC(rms)
额定电流	**1.5A Max. at 25℃**	
使用温度范围	**-40℃ ~ +85℃**	
使用湿度范围	**95%R.H. MAXIMUM**	

5. 试验环境

产品的设计应符合规定的电气, 机械及环境性能。除非特别说明之外，一般试验及测量将于温度 15~35℃，相对湿度 25~85%，大气压力 86 ~106kPa 之条件下完成，但若上述条件下有任何影响判定值的疑虑，可考虑在温度 20 ±2℃，相对湿度 60~70%及大气压力 86~106kPa 之条件下完成试验。

6. 外观

经目视观察，外观不可有变形，电镀脱落等会降低其功能的异常现象，也不可有严重破裂、刮伤或污损之缺点。

7. 测试条件及要求摘要

7.1 电气特性

编号	项 目	条 件	规 格
7.1.1	接触阻抗	EIA364-23 在配对好公头与插座上进行测试. 开路电压：20mV 以下 电流：100mA 以下	35mΩ Max.
7.1.2	绝缘阻抗	EIA364-21 在连接器相邻电流间或与接地端进行测试。 电压：500V DC.	1000MΩ Min。
7.1.3	耐电压	EIA 364-20 在连接器相邻电流间或与接地端进行测试。 电压：1000V AC 50 或 60HZ，持续 1 分钟。	无击穿或火花发生 漏电流：< 1.5mA

MODULAR JACK CONNECTOR

7.2 MECHANICAL PERFORMANCE［机械特性］

编号	项 目	条 件	规 格	
7.2.1	插入力	EIA 364-13 操作速度：不超过 10mm/秒速度，测量插入水晶头所需的力。	22N (2.24Kgf) Max.	
7.2.2	拔出力	EIA 364-13 操作速度：不超过 10mm/秒速度，测量拔出水晶头所需的力。(水晶头除去锁扣舌片)	22N (2.24Kgf) Max.	
7.2.3	配合强度	EIA 364-98 配对插头与插座，以不超过 10mm/秒的速度，测量拔出插头所需的力。	50N (5.10Kgf) Min.	
7.2.4	机械寿命	EIA 364-09 操作速度：不超过 300 次/小时和 10mm/秒速度，插拔次数：750 次，水晶头锁扣舌片处于无功能状态。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50mΩ Max.
7.2.5	可焊性	EIA 364-52 产品锡脚放置在助焊剂中浸润 5S 后再插入锡炉中 2mm 深进行粘锡测试。 焊锡温度：245±3℃； 焊锡时间：5±0.5 秒（使用助焊剂）。	最少 95%的沾锡面积。	

7.3 环境特性及其它

编号	项 目	条 件	规 格	
7.3.1	耐焊接热	EIA 364-56 人工焊：3±1 秒 350±10℃； 自动焊：260±5 ℃，10±1秒	外观	不可损坏
7.3.2	耐高温	EIA-364-17 配对插头与插座，温度 85±2℃，持续 96 小时。经试验后，连接器须于室温中放置 1~2 小时，再测定其值。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.
7.3.3	耐低温	EIA-364-59 配对插头与插座，温度-40±2℃，持续 96 小时。经试验后，连接器须于室温中放置 1~2 小时，再测定其值。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.

（继续）

MODULAR JACK CONNECTOR

编号	项 目	条 件	规 格	
7.3.4	温度循环	EIA-364-32 配对插头与插座，在温度-40±2℃箱体内放置 0.5 小时,然后在 85±2℃箱体中放置 0.5 小时，5 个循环后取出样品在室温中恢复 1~2 小时。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.
7.3.5	耐湿性	EIA 364-31 配对插头与插座，在温度 40±2℃,湿度 90~95%RH 的箱体内放置 96 小时，取出样品在室温中恢复 1~2 小时。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.
			绝缘阻抗	500 MΩ MIN.
			耐电压	500 VAC，1 分钟
7.3.6	盐水喷雾	EIA-364-26 将配对的插头与插座放置于 PH 值为 6.5~7.2 的 5±1% Nacl 盐雾环境中，测试完成后，用清水冲洗样品，在室温中恢复 1 小时。 盐雾时间（镀金）： （Fu"、G/F）：12 小时， （3u"~10u"）：24 小时， （15u"~30u"）：48 小时。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.

注意：产品如果是由 PBT 组成，在焊接过程中定位柱可能会出现熔胶现象（熔胶温度为≥230℃，时间为 3 秒后）。

（结束）

8. 包装、运输、储存

8.1 包装

产品应装在干燥的、防潮的、防尘和防霉箱子中。包装箱的外表部应注明相应产品名称、型号、料号、数量以及日期、检验印章等。

8.2 运输

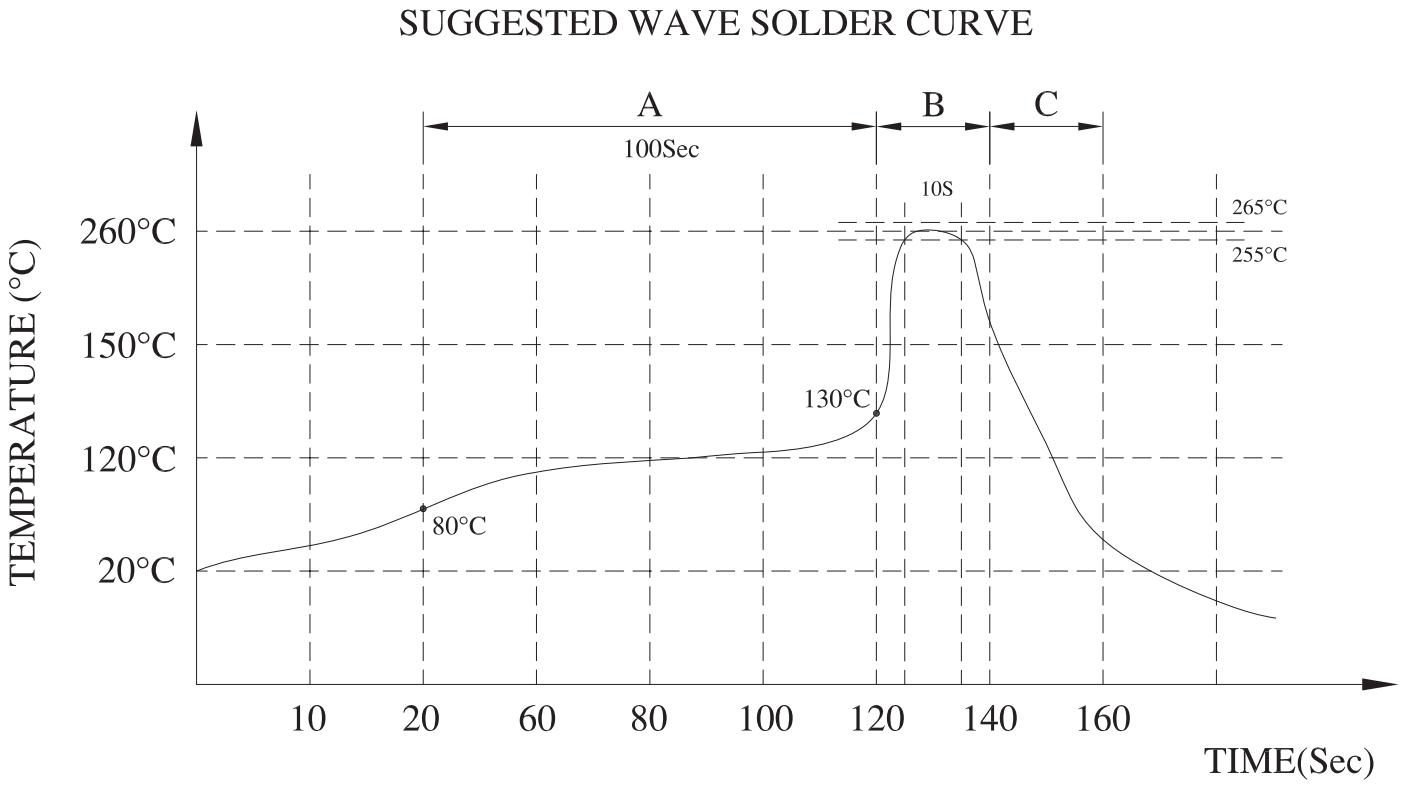
包装成箱的产品，在避免雨雪直接淋袭的条件下，可用任何运输工具运送。

8.3 储存

包装成箱的产品，建议在环境温度-10～+40℃，相对湿度不大于 80%内保管，应储存在周围空气中没有酸性、碱性或其它腐蚀性气体的库房中。若需长期保存，请勿打开包装箱。

MODULAR JACK CONNECTOR

9. 波峰焊曲线图



A. Preheating B. Soldering C. Gradual Cooling